

2021年度精密工学会春季大会学術講演会 講演セッション一覧

<分類表>

A：設計・生産システム

B：精密加工

C：メカトロニクス・精密機器

D：精密計測

E：人・環境工学

F：材料・表面プロセス

G：バイオエンジニアリング

H：ナノテクノロジー・新領域

分類	コード	OS/一般	セッション名	オーガナイザー	キーワード
A	01	OS	形状モデリングの基礎と応用	大竹 豊(東京大), 吉澤 信(理化学研), 道川 隆士(理化学研), 森口 昌樹(中央大), 長井 超慧(東京都立大)	形状モデリングと製造支援, CAGD, エンジニアリングシミュレーション, コンピュータグラフィックス
A	02	OS	デジタルスタイルデザイン	小林 一也(富山県立大), 青山 英樹(慶應義塾大)	意匠設計(スタイルデザイン), リバースエンジニアリング, 3次元形状モデリング技術, 意匠形状評価技術
A	03	OS	持続可能なものづくりのためのライフサイクルエンジニアリング	高田 祥三(早稲田大), 梅田 靖(東京大), 増井 慶次郎(産総研)	持続可能社会, ライフサイクル設計, ライフサイクルマネジメント, サステナブル・マニファクチャリング
A	04	OS	サイバーフィールド構築技術	増田 宏(電気通信大), 伊達 宏昭(北海道大), 石川 貴一郎(日本工業大), 溝口 知広(日本大)	3次元環境計測データからのモデル構築, 大規模形状計測データに対する情報処理, フィールド計測技術(画像, レーザなど), サイバーフィールドの利活用と業務支援
A	05	OS	オープン指向のCAD/CAM開発	浅川 直紀(金沢大), 乾 正知(茨城大), 金子 順一(埼玉大), 高杉 敬吾(金沢大)	CAD, CAM, CAE, CAT, オープン開発, カーネル内製化
A	06	OS	金型設計・生産技術	村田 泰彦(日本工業大), 榎原 弘之(九州工業大), 新川 真人(岐阜大), 福島 祥夫(埼玉工業大)	金型CAD/CAM/CAE, 金型加工, プラスチック成形加工, 塑性加工
A	07	OS	スマートエンジニアリングシステムの設計・応用	山本 雅人(北海道大), 成瀬 継太郎(会津大), 林 朗弘(九州工業大)	群知能, 進化と学習, マルチエージェント, 複雑システム
A	08	OS	システムのシンセシス(設計・サービス・生産システム)	下村 芳樹(東京都立大), 岩村 幸治(大阪府立大), 千葉 龍介(旭川医科大), 妻屋 彰(岡山県立大), 長井 超慧(東京都立大), 野間口 大(大阪大), 藤井 信忠(神戸大), 森永 英二(大阪府立大)	設計プロセス, 設計手法, 設計教育, 設計モデル, 設計評価, サービス設計, PSS(Product-Service Systems, 製品サービスシステム), 設計論, 設計知識, 最適化, ロバスト設計, 信頼性設計, QFD(Quality Function Development), DFX(Design for X), プロダクトファミリー, VR(Virtual Reality)応用, 生産システム, 生産計画, 工程計画, サプライチェーン, 生産シミュレーション, スマートファクトリー
A	09	OS	サステナブル生産のためのヒューマンモニタリングとスキル分析	杉 正夫(電気通信大), 中嶋 良介(電気通信大), 山田 哲男(電気通信大)	サステナブル生産, 循環型生産, スマートデバイス, 機械学習
B	01	OS	工作機械の高速高精度化	松原 厚(京都市大), 森本 喜隆(金沢工業大), 千田 治光(オークマ), 吉岡 勇人(東京工業大), 白瀬 敬一(神戸大)	工作機械, 高速化, 高精度化, 高機能化
B	02	OS	高能率・高精度化のための切削工具	臼杵 年(東京大), 關谷 克彦(広島大), 榎原 弘之(東京農工大), 高橋 秀史(三菱マテリアル)	切削工具, 切削加工技術, 切削特性
B	03	OS	多軸制御加工計測	森重 功一(電気通信大), 茨木 創一(広島大), 竹内 芳美(中部大)	多軸制御, 加工, 計測, 精度補正
B	04	OS	穴加工および穴形状精度の測定	甲木 昭雄(九州大)	穴加工, 穴精度測定, 掘削
B	05	OS	超音波振動を援用した加工技術	神 雅彦(日本工業大), 磯部 浩巳(長岡技科大)	超音波振動切削, 超音波振動研削, 超音波振動研磨
B	06	OS	研削現象とその機構	大橋 一仁(岡山大), 山田 高三(日本大), 藤本 正和(近畿大)	研削現象, 研削機構, 加工計測, 研削シミュレーション
B	07	OS	超砥粒ホイール応用加工技術の新展開	太田 稔(京都市芸繊維大), ニノ宮 進一(日本工業大), 岩井 学(富山県立大), 澤 武一(芝浦工業大)	超砥粒ホイール, ツルーイング・ドレッシング, 研削盤, 超砥粒ホイール応用加工技術
B	08	OS	曲面・微細形状の超精密加工と計測	山形 豊(理化学研), 森田 晋也(東京電機大), 古城直道(関西大), 林 偉民(群馬大), 柿沼 康弘(慶應義塾大), 鈴木 浩文(中部大), 三浦 勝弘(三鷹光器), 福田 将彦(芝浦機械)	曲面・微細加工, 超精密加工, 超精密計測
B	09	OS	ナノ表面研削/ELID研削	大森 整(理化学研), 林 偉民(群馬大), 伊藤 伸英(茨城大), 上原 嘉宏(理化学研), 水谷 正義(東北大)	ナノ精度, 鏡面研削, ELID研削
B	10	OS	切断加工	坂本 智(横浜国立大), 諏訪部 仁(金沢工業大)	切断, スライシング, ダイシング, 割断
B	11	OS	砥粒加工の新展開	榎本 俊之(大阪大), 桐野 宙治(クリスタル光学)	ポリッシング・ラッピング, 高平坦研磨加工, 固定砥粒研磨加工, 超精密研磨加工, メカノケミカル研磨加工, 噴射加工, 工作物の高精度保持
B	12	OS	複合研磨	鄒 艶華(宇都宮大), 川久保 英樹(信州大), 赤上 陽一(秋田県産技セ), 西田 均(富山高専), 佐藤 隆史(IHI)	磁場・電場援用研磨(加工), 電気・磁気粘性流体利用加工
B	13	OS	プラナリゼーションCMPとその応用	森永 均(フジミンコーポレートッド), 黒河 周平(九州大), 畠田 道雄(金沢工業大)	プラナリゼーションCMP, 超精密研磨, 半導体材料, 消耗材技術(スラリー・パッド・コンディショナー), 装置化技術, デバイスプロセス, 評価技術, ラッピング・ポリッシング, 鏡面・平坦化加工(含む研削), 複合・援用研磨, 新研磨・仕上げ加工法, その他
B	14	OS	電気エネルギー応用加工	早川 伸哉(名古屋工業大), 金子 健正(長岡高専)	放電加工, 電解加工, レーザ加工
B	15	OS	レーザ加工	桑野 亮一(広島工業大), 布引 雅之(兵庫県立大), 江面 篤志(金沢大学)	レーザ加工, レーザ, 微細加工, 材料加工
B	16	OS	エンドミル加工技術	松村 隆(東京電機大), 吉川 浩一(九州工業大), 杉田 直彦(東京大), 金子 順一(埼玉大)	エンドミル加工, 切削機構, 切削性能, 切削シミュレーション

分類	コード	OS/一般	セッション名	オーガナイザー	キーワード
B	17	OS	機能形状創製 (付加製造, 3Dプリンティング, MID)	新野 俊樹(東京大)	付加製造, 3Dプリンティング, MID
B	18	OS	次世代基盤研磨技術の創成	須田 聖一(静岡大), 赤上 陽一(秋田県産技セ), 久保 百司(東北大)	次世代研磨技術, 砥粒開発, 数値解析, 副資材開発, 砥粒再生技術
C	01	OS	精密・超精密位置決め	佐藤 海二(豊橋技術科学大), 若園 賀生(ジェイテクト), 佐藤 隆太(神戸大)	位置決め, 制御, 機構, センサ
C	02	OS	次世代センサ・アクチュエータ	森田 剛(東京大), 岩附 信行(東京工業大), 古谷 克司(豊田工業大)	圧電アクチュエータ, 超磁歪アクチュエータ, 熱変形アクチュエータ, 高分子アクチュエータ
C	03	OS	ロボティクス・メカトロニクス	杉 正夫(電気通信大), 関 啓明(金沢大), 金森 哉史(電気通信大), 本田 智(東京都立大), 山本 晃生(東京大)	ロボティクス, メカトロニクス, センサ, アクチュエータ
C	05	OS	マイクロ生産機械システム	長谷 亜蘭(埼玉工業大), 岡崎 祐一(産総研), 金子 義幸(高松機械工業), 木村 広幸(湘南工科大)	マイクロ工作機械, マイクロファクトリー, マイクロ組立, 生産システムの小型化, 微小部品加工
D	01	OS	光応用技術・計測	水谷 康弘(大阪大), 石原 満宏(東光高岳), 石丸 伊知郎(香川大), 大谷 幸利(宇都宮大), 西島 直樹(ハルステック工業), 藤垣 元治(福井大)	光応用技術(三次元計測, 形状計測, 光センシング, 生体・医用計測, 高速度計測, 機器光学, オプトメカトロニクス), イメージング・光情報処理(光イメージング, デジタルオプティクス, 光物性), 光学新領域(プラズモン, テラヘルツ, X線, 中赤外等も含む)
D	02	OS	知的精密計測	高谷 裕浩(大阪大), 高増 潔(東京大), 高橋 顕(ニコン), 園谷 寛夫(ニコン), 中村 吉助(小坂研究所), 清水 裕樹(東北大)	知的計測
D	03	OS	画像技術と産業システム応用	廣瀬 誠(松江高専), 笹谷 聡(日立製作所), 水谷 彰宏(日本ガイシ)	画像処理, 画像応用, 産業システム, 実利用, 知能化システム
D	04	OS	X線光学のための精密技術	松山 智至(名古屋大), 湯本 博勝(高輝度光科学研セ), 木村 隆志(東京大)	X線光学系, X線イメージング, X線CT, X線非破壊検査装置, X線分析装置, X線リソグラフィ, X線検出器, X線顕微鏡, X線望遠鏡
E	01	OS	医用・人間工学	佐久間 一郎(東京大), 太田 裕治(お茶の水女子大), 垣本 映(職能開発総合大)	医用機器, 福祉機器, 人間共存型機器, 生活支援機器
E	02	OS	生産原論	伊藤 昌樹(関東職能開発大), 伊藤 伸英(茨城大), 河西 敏雄(河西研磨技術特別研究室/元 埼玉大), 池野 順一(埼玉大)	技術者倫理, 生産哲学, モノづくり, 技術史, 工学教育, 技術伝承, 感性
F	01	OS	表面処理・機能薄膜	垣内 弘章(大阪大), 井上 尚三(兵庫県立大), 安武 潔(大阪大), 大竹 尚登(東京工業大), 坂本 仁志(クリエイティブコーティングス)	表面処理技術, 薄膜形成, 機能薄膜, 表面特性
F	02	OS	プラズマ加工・材料プロセス	大宏 宏昌(大阪大), 山村 和也(大阪大), 須崎 嘉文(香川大)	ドライエッチング, 材料合成, 物質変換, 材料改質, ガス改質, 新規プラズマ応用技術, プラズマ計測, プラズマシミュレーション
G	01	OS	マイクロニードル(作製法とアプリケーション)	青柳 誠司(関西大), 榎谷 和義(東海大), 金 範埃(東京大), 加藤 暢宏(近畿大)	マイクロニードル, ニードルアレイ, ニードルパッチ, 無痛針, MEMS, 微細加工, 医療応用
G	02	OS	バイオ・医療への応用展開	初澤 毅(東京工業大), 柴田 隆行(豊橋技科大), 早瀬 仁則(東京理科大), 金子 新(東京都立大), 青柳 誠司(関西大), 榎谷 和義(東海大),	生体分子・細胞マニピュレーション, 生体分子・細胞機能解析, バイオイメージング, バイオアセンブリ, 細胞培養, バイオマテリアル, バイオ機能表面, バイオデバイス, バイオMEMS, マイクロTAS, 医用センサ, 医用マイクロメカニズム, 微細加工, 3Dバイオプリンティング
H	01	OS	マイクロ・ナノ加工とその応用	金子 新(東京都立大), 角田 陽(東京高専), 比田井 洋史(千葉大), 川堰 宣隆(富山県産技セ), 清水 淳(茨城大), 倉本 智史(島津製作所)	微細加工, 超精密加工, 表面機能とその評価, トライボロジー
H	02	OS	マイクロ/ナノシステム	中里 裕一(日本工業大), 伊藤 高廣(九州工業大), 寺田 英嗣(山梨大学), 松井 伸介(千葉工業大), 見崎 大悟(工学院大)	マイクロ/ナノシステム, マイクロメカニズム, マイクロマシン, マイクロ/ナノメカニズム, MEMS/NEMS, MOEMS/NEOMS, マイクロアクチュエータ, センサ, 光デバイス, マニファクチャリングシステム, アセンブリングシステム, デザインシステム
H	03	OS	MEMS商業化技術	尹 成圃(産総研), 小久保 光典(芝浦機械), 村上 直(九州工業大), 藤野 真久(産総研), 岩崎 渉(産総研)	MEMS デバイス応用, デバイス・材料評価, MEMSデバイス 作製技術, アセンブリ/パッケージング, マイクロ接合, ナノインプリント
H	04	OS	表面ナノ構造・ナノ計測	有馬 健太(大阪大学), 岩田 太(静岡大)	ナノファブリケーション, ナノストラクチャー, プローブ顕微鏡